

# 日印デジタル・パートナーシップ2.0

令和7（2025）年8月  
経済産業省

- 2018年10月、経産省とインド電子IT省との間で「日印デジタル・パートナーシップ」に合意し、協力覚書を締結。世耕経済大臣とチノイ駐日インド大使が署名。同月、モディ首相が訪日し、安倍首相と会談、本パートナーシップを含む文書交換式を実施。
- 今次首脳会談に合わせ、協力項目を更新する形で「日印デジタル・パートナーシップ2.0」を締結。

## 日印デジタル・パートナーシップの協力項目（今次更新）

※赤字は新規の項目と要素

### 1. 半導体エコシステム

「半導体SCパートナーシップ」MoCに基づき実施

※ 当該MoCでも本パートナーシップを引用

- 両国の半導体研究開発機関の更なる連携
- 半導体等分野における両国の投資促進
- 半導体サプライチェーンの強靱化の促進 等

### 2. AI

- GPAI、広島AIプロセス・フレンズグループ、国連、AI安全性サミット等の多国間会合における協力
- AIに関する知見の共有
- 信頼できるAIエコシステム実現に向けた協力 等

### 3. デジタル企業連携

- グローバル市場向け製品・ソリューション開発
- 研究開発のネットワーキング
- 両国エレクトロニクス・ITセクターへの投資促進 等

### 4. デジタル公共インフラ

- 政策、ルール、規制に関するベスト・プラクティスの共有
- デジタルID等を含むDPIソリューション実装の探求
- 金融、農業、交通等の主要分野におけるデジタル公共インフラの開発協力 等

### 5. デジタル人材

- 半導体分野におけるグローバルレベルの人材育成
- 日本企業の教育プログラム提供をインドの大学に拡大
- インターンシップ・プログラムの開催
- インドでのジョブ・フェアの開催 等

### 6. 研究開発協力

- Society 5.0とインドの取組の専門知識・経験の共有
- HPC、AI等の新技術の研究協力の強化
- デジタル技術を活用した課題解決型事業支援

### 7. スタートアップ連携

- スタートアップ・エコシステムの連携
- 投資ファンドの設立奨励
- CoEに関するベスト・プラクティス共有
- 両国スタートアップのピッチングやビジネスマッチングの機会創出

### 8. 次世代ネットワークのためのセキュリティ

- サイバーセキュリティ能力開発、訓練に関する協力
- CERT間の協力活動の促進
- 標準・認定プロセス開発、適合性評価における協力 等